

SMD –
Transponderspule**Kennzeichen:**

- ▶▶ Großer Induktivitätsbereich
- ▶▶ Geringe Höhe
- ▶▶ Automatisch bestückbar
- ▶▶ Für Reflow- und Dampfphasenlötung
- ▶▶ Gute Vibrations- und Falltesteigenschaften

Anwendungen:

- ▶▶ Transponder-, Identifikations- und Sicherungssysteme (z. B. KFZ-Bereich)
- ▶▶ Datenübertragung 5-200 kHz

Daten:

Induktivitätsbereich:

1 μ H - 39 mH

Empfohlene Löttechnik:

Reflow

max. Löttemperatur:

260°C, 10 Sek.

Betriebstemperaturbereich:

-40°C bis + 125°C

Energiegehalt:

ca. 1,5 μ Ws

Verpackung siehe Seite 4.90:

Blisterpack IEC 286 / 3

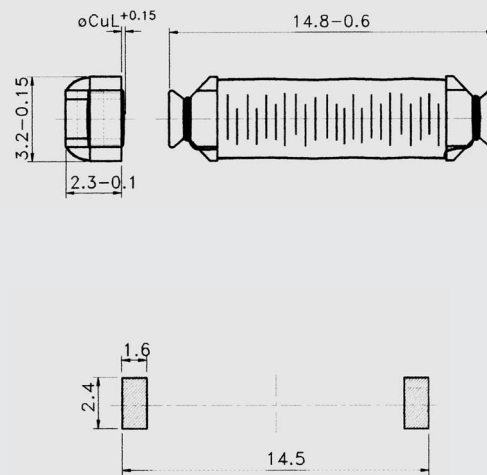
Verpackungseinheit

(Stück/Rolle): 3200

MS 32 c

Abmessungen und Lötflächen (mm):

Dimensions and footprint (mm):

SMD –
Transponder coil**Features:**

- ▶▶ Wide inductance range
- ▶▶ Low height
- ▶▶ Suitable for automatic insertion
- ▶▶ For reflow and vapor phase soldering
- ▶▶ Good vibration- and drop test performance

Applications:

- ▶▶ Transponder-, Identification- and Safety-Devices (e. g. for automotive systems)
- ▶▶ Data transmission 5-200 kHz

Data:

Inductance range:

1 μ H - 39 mH

Recommended soldering

method: Reflow

Soldering heat resistance:

260°C, 10 sec.

Operating temperature range:

-40°C to + 125°C

Storage-Energy:

ca. 1,5 μ Ws

Packaging see page 4.90:

Blisterpack IEC 286 / 3

Packaging unit (parts / reel):

3200

**Vorläufige Daten/
Preliminary data:**

L [μ H]	\pm *) %	R \leq [Ω]	f _{res} \geq [MHz]	I _{max} [mA]	Art.-Nr. Part number
10	10	0,12	200	560	00 6132 10
47	10	0,27	8	260	00 6132 14
100	10	0,52	4,5	180	00 6132 16
330	10	4	1,5	80	00 6132 19
1,2 k	10	7	1	50	00 6132 34
5,6 k	10	32	0,4	24	00 6132 35
8,2 k	10	40	0,34	20	00 6132 40
39 k	10	200	0,15	8	00 6132 41

E-12-Reihe in Vorbereitung.
E-12-serial in preparation.ASF + HSF möglich.
ASF + HSF available.

Neuheit

new

SMD – Transponderspule

Kennzeichen:

- ▶▶ Großer Induktivitätsbereich
- ▶▶ Geringe Höhe
- ▶▶ Automatisch bestückbar
- ▶▶ Für Reflow- und Dampfphasenlötung
- ▶▶ Ansaugfläche oder Halbverguss
- ▶▶ [Verklebung mit PCB durch HSF](#)

Anwendungen:

- ▶▶ Transponder-Antennen
- ▶▶ Entkopplung in HF- und ZF-Schaltungen
- ▶▶ Einsatz in selektiven Kreisen

Daten:

Induktivitätsbereich:
1 μ H - 39 mH

Empfohlene Löttechnik:
Reflow

max. Löttemperatur:
260°C, 10 Sek.

Betriebstemperaturbereich:
-40°C bis + 125°C

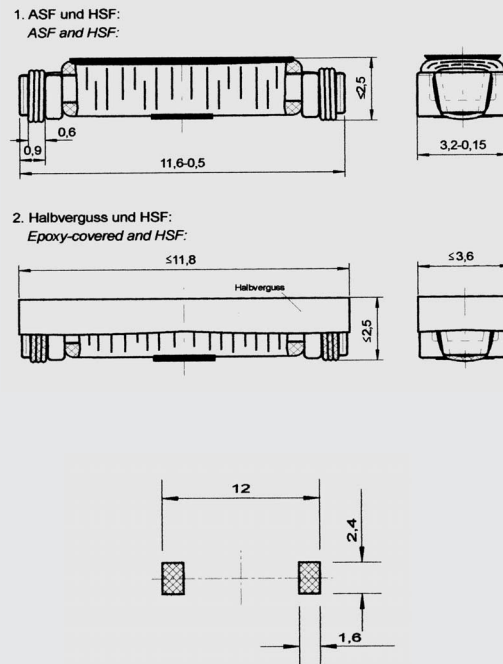
Verpackung siehe Seite 4.90:
Blisterpack IEC 286 / 3

Verpackungseinheit
(Stück/ Rolle): 3200

Ms 32 k

Abmessungen und Lötflächen (mm):

Dimensions and footprint (mm):



SMD – Transponder coil

Features:

- ▶▶ Wide inductance range
- ▶▶ Low height
- ▶▶ Suitable for automatic insertion
- ▶▶ For reflow and vapor phase soldering
- ▶▶ Pick and place area or epoxy-covered
- ▶▶ [Glueing with PCB by HSF \(hot melting dot\)](#)

Applications:

- ▶▶ Transponder antennas
- ▶▶ Decoupling in RF- and IF-circuits
- ▶▶ Use in frequency selective circuits

Data:

Inductance range:
1 μ H - 39 mH

Recommended soldering
method: Reflow

Soldering heat resistance:
260°C, 10 sec.

Operating temperature range:
-40°C to + 125°C

Packaging see page 4.90:
Blisterpack IEC 286 / 3

Packaging unit
(parts / reel): 3200

Vorläufige Daten/ Preliminary data:

L [μ H]	\pm %	R [Ω]	f_{res} [MHz]	Q \geq	f_Q [kHz]
0,4 k	10	2,8	1,5	12	125
1,6 k	10	11	0,9	10	125
2,37 k	5	17	0,6	15	125
2,5 k	10	42	0,55	15	125
7,2 k	5	40	0,3	12	125

Neuheit

new

SMD – Transponderspule

Kennzeichen:

- ▶▶ Großer Induktivitätsbereich
- ▶▶ Geringe Höhe
- ▶▶ Automatisch bestückbar
- ▶▶ Für Reflow- und Dampfphasenlötung
- ▶▶ Ansaugfläche oder Halbverguss
- ▶▶ [Verklebung mit PCB durch HSF](#)
- ▶▶ Hohe Q-Werte
- ▶▶ Gute Vibrations- und Falltesteigenschaften

Anwendungen:

- ▶▶ Transponder-Antennen
- ▶▶ Entkopplung in HF- und ZF-Schaltungen
- ▶▶ Einsatz in selektiven Kreisen

Daten:

Induktivitätsbereich:

1 μ H - 39 mH

Empfohlene Löttechnik:

Reflow

Betriebstemperaturbereich:

-40°C bis + 125°C

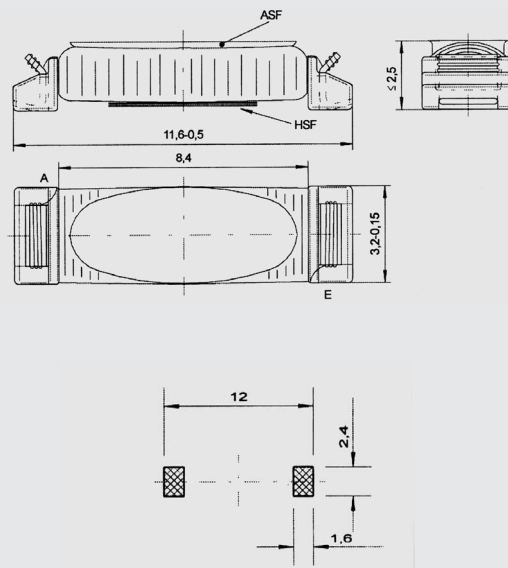
Verpackung siehe Seite 4.90:

Blisterpack IEC 286 / 3

Ms 32 ka

Abmessungen und Lötflächen (mm):

Dimensions and footprint (mm):



SMD – Transponder coil

Features:

- ▶▶ Wide inductance range
- ▶▶ Low height
- ▶▶ Suitable for automatic insertion
- ▶▶ For reflow and vapor phase soldering
- ▶▶ Pick and place area or epoxy-covered
- ▶▶ [Glueing with PCB by HSF \(hot melting dot\)](#)
- ▶▶ High Q-values
- ▶▶ Good vibration- and drop test performance

Applications:

- ▶▶ Transponder antennas
- ▶▶ Decoupling in RF- and IF-circuits
- ▶▶ Use in frequency selective circuits

Data:

Inductance range:

1 μ H - 39 mH

Recommended soldering

method: Reflow

Operating temperature range:

-40°C to + 125°C

Packaging see page 4.90:

Blisterpack IEC 286 / 3

Vorläufige Daten/ Preliminary data:

L [μ H]	\pm %	R [Ω]	f_{res} [MHz]	Q \geq	f_Q [kHz]
2,37 k	5	23	0,6	50	125
7,2 k	5	45	0,3	40	125

Neuheit

new